

第8回ユニーク・自作チップ・コンテスト 前回からの変更点

以下の点について、今回から変更となりますので、ご注意ください。

1. 参加必要日数の変更（緩和）

- ・前回までは、ウェハプロセス（11.5日間）の内、2/3以上（8日以上）に参加できることを、参加条件としていました。
- ・今回からは、この条件を緩和し、ウェハプロセス（12日間）の内、2017年9月7日（木）・9月8日（金）を含む2日以上参加できることを、参加条件とすることに変更します。
※2017年9月7日（木）と9月8日（金）の参加は、必須です。

2. パッケージング方法の変更

- ・前は、パッケージングまでコンテストの会場である「共同研究開発センター」で行い、コンテストに参加された方々にも、パッケージング作業の一部を行っていただきました。
- ・今回は、前々回の方法に戻し、ウェハプロセスと簡単な測定作業までを参加者に行っていただき、パッケージングは外部の専門業者に委託します。
- ・チップも、ディップタイプのセラミックパッケージ（48pinタイプ）から、前々回と同じ樹脂モールドされたフラットタイプのものに変更となります。



試作チップのイメージ

3. 前記2.に伴う変更

- ・参加者に使用いただける pin 数は、48pin から 52pin になります。
- ・お送りするチップの個数は、前回の3個から、10個に増えます。

以上